CU-703氰化镀铜光亮剂

产品说明书

一、特　点

1、该光亮剂是全有机型的，不含铅盐，可获得全光亮、无脆性的铜镀层；

2、电流效率也较高，能达到85%，因此沉积速度快，比硫酸镀铜节电30%左右；

3、分散能力和深镀能力佳，特别使用锌和铝合金件电镀；

4、挂镀和滚镀通用。

二、配方和工艺条件（g/L）

名　称	工艺范围
氰化亚铜	55～85g/L
游离氰化钠	10～15g/L
氢氧化钠	0～15g/L
CU-703光亮剂	10～12mL/L
温 度	55～65℃
Dk(阴极移动)	1～3A/dm2

三、配方说明

1、配制时先放1/2槽热的纯水，投入氰化钠，搅拌溶解，再投入计算量的氰化亚铜，搅拌至完全溶解，乘热加入活性炭2g/L，搅拌30分钟，静置数小时，再加入CU-703光亮剂，用DK0.1～0.5A/dm2电解数小时后即可正常电镀；

2、如果是电镀锌和铝合金件，就不能加氢氧化钠，不然会气泡，影响结合力；

3、如果槽液中加30～40g/L酒石酸钾钠，对改善阳极溶解有好处，但同时需降低游离氰化钠含量到5～10g/L；如镀液易遭受铬酸污染，以不加酒石酸钾钠为宜；但游离氰化钠需提高到10～15g/L；

4、由于氰化钠分解，槽液中碳酸钠含量会愈来愈高，超过80g/L时镀层结晶粗糙，要用冷冻法定期除去；

本资料参数为典型参考值，实际使用需按基材、槽体、装载量、水质与整流条件调整；需要对应工况的参数建议，请联系我们取样验证。

5、光亮剂消耗量250～350mL/KAH，视镀层光亮程度添加，以少加勤加为宜。

南京华仁新材料科技有限公司